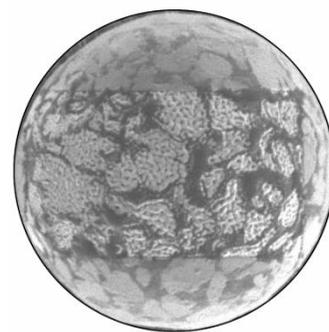


IMC Sheet



独自開発した IMC 微粒子が優れた高温耐久性を実現

特 長

・バインダーフリー・ハロゲンフリーで低ボイドおよび無洗浄を実現します

100%金属成分で有機物残渣がなく無洗浄での使用が可能。余分なガスの発生がなくペーストでは不可能であった低ボイド化を実現

・IMC 微粒子の介在により、低温領域における低温耐性を高めます

・IMC 微粒子の介在により、高温耐久性を高めます

IMC（融点：約 450℃）が介在することで、ブリード（フラッシュ）が起こりにくく、再加熱時の形状安定性を確保

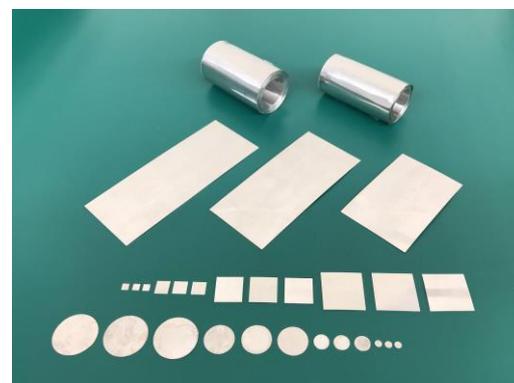
・階層接合がこの IMC シートのみで可能になります

あらゆる温度階層の接合もこの IMC シートのみで一括接合が可能

・IMC 微粒子の介在により、ウイスカの発生がありません

・AuSn に比べ高いコストパフォーマンスを実現します

・プリフォーム加工も承ります



用 途

・パワーデバイス、LED 等の接合全般（チップ接合、ヒートシンクと DCB 基板の接合など）

・気密性を有するキャップやパッケージの封止（金属封止）

特 性

項 目	CB20	CB10	BE30
合金組成	Sn-26.4Cu	Sn-17.2Cu	Sn-19.6Bi-2.4Cu
その他金属添加物	Ni	Ni	Ni
融点（℃）	227～230℃	227～230℃	138～141℃
耐熱性（℃）	約 300℃	約 280℃	約 200℃
電気抵抗率（ $\mu\Omega\cdot\text{cm}$ ）※1	12～15	12～15	12～15
熱伝導率（W/m・K）※1	40～50	40～50	40～50
ヤング率（GPa）	10～50	10～50	10～50
CTE（ppm/K）	19～22	19～22	19～22

※1 推定値

■ 立石本社

〒124-0013 東京都葛飾区東立石 2-19-9

TEL：03-3694-1530

FAX：03-3694-1528

■ 川越事業所

〒350-1155 埼玉県川越市下赤坂 137

TEL：049-265-5948

FAX：049-265-5958